

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

美芯晟科技（北京）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-005

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	Hel Ved Capital Management Limited; HUAFU SECURITIES CO.,LTD.; 安徽国富产业投资基金管理有限公司; 百川财富(北京)投资管理有限公司; 北京才誉资产管理企业(有限合伙); 北京永瑞财富投资管理有限公司; 博时基金管理有限公司; 才华资本管理有限公司; 财通证券股份有限公司; 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司; 大家资产管理有限责任公司; 东方证券股份有限公司; 东吴证券股份有限公司; 东兴基金管理有限公司; 复通(山东)私募投资基金管理有限公司; 广东佳润实业有限公司; 广东正圆私募基金管理有限公司; 广发证券股份有限公司; 广西赢舟管理咨询服务有限公司; 广州睿融私募基金管理有限公司; 广州市玄元投资管理有限公司; 国海证券股份有限公司; 国金证券股份有限公司; 国联证券股份有限公司; 国泰君安证券股份有限公司; 国信证券股份有限公司; 海南悦溪私募基金管理合伙企业(有限合伙); 海通证券股份有限公司; 宏利基金管理有限公司; 鸿商资本股权投资有限公司; 鸿运私募基金管理(海南)有限公司; 湖南源乘私募基金管理有限公司; 华安财保资产管理有限责任公司; 华安证券股份有限公司; 华福证券有限责任公司; 华金证券股份有限公司; 华杉瑞联基金管理有限公司; 华泰证券股份有限公司; 华西证券股份有限公司; 汇泉基金管理有限公司; 江苏第五公理投资管理有限公司; 江苏汇鸿汇升投资管理有限公司; 九泰基金管理有限公司; 开源证券股份有限公司; 凯盛融英

	<p> 信息科技(上海)股份有限公司；民生证券股份有限公司；摩根士丹利华鑫基金管理有限公司；磐厚动量(上海)资本管理有限公司；瑞银证券有限责任公司；上海百济投资管理有限公司；上海禅龙资产管理有限公司；上海贵源投资有限公司；上海雷钧资产管理有限公司；上海名禹资产管理有限公司；上海盘京投资管理中心(有限合伙)；上海骐邦投资管理有限公司；上海申银万国证券研究所有限公司；上海天猷投资管理有限公司；上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙)；上海煜德投资管理中心(有限合伙)；深圳丞毅投资有限公司；深圳大道至诚投资管理合伙企业(有限合伙)；深圳市恒悦资产管理有限公司；深圳市惠通基金管理有限公司；深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司；太平基金管理有限公司；西部证券股份有限公司；西藏信托有限公司；西南证券股份有限公司；新活力资本投资有限公司；信达证券股份有限公司；兴合基金管理有限公司；兴业基金管理有限公司；兴业证券股份有限公司；亚太财产保险有限公司；长城财富资产管理股份有限公司；长城基金管理有限公司；招商证券股份有限公司；招商证券资产管理有限公司；郑州云杉投资管理有限公司；中国工商银行股份有限公司；中国国际金融股份有限公司；中国民生银行股份有限公司；中航证券有限公司；中泰证券股份有限公司；中信建投证券股份有限公司；中信证券股份有限公司；中邮创业基金管理股份有限公司；中邮人寿保险股份有限公司；中邮证券有限责任公司； </p>
时间	2024年4月30日
地点	公司会议室等
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 程宝洪 董事会秘书 刘雁 财务负责人 于龙珍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、 公司基本情况概述</p> <p>2023年公司实现营业收入4.72亿元,同比增长7.06%,归属于上市公司股东的净利润为3,015.35万元,同比下降42.67%。公司研发投入10,274万元,同比增长56.31%。截止2023年底,</p>

公司研发人员数量达到了 168 人，同比增长了 47.37%，研发人员的数量占公司的总人数 62.92%，主要是公司在无线充电、模拟电源、光传感、还有车规级产品等方向加大研发投入和人才梯队建设。公司在 2023 年度拟实施利润分配和资本公积金转增股本的方案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 793.94 万元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 26.33%；拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。2024 年第一季度公司实现了营业收入 9,467.49 万元，同比增长 18.26%。公司持续加大研发投入，一季度公司的研发投入金额为 3,274 万元，同比增长 81%，占公司营业收入的比例是 34.58%，研发人员的数量同比增加了 52.50%。

二、提问环节

1、市场看到公司整体产品布局更加全面和平台化，关于新品的研发情况和客户导入情况是怎样的？

公司起源于 LED 驱动芯片，后来扩展到数模混合 SoC 领域，主要涉及无线充电、嵌入式软件等方面。近年来，公司进入信号链市场，分为传感器和汽车电子领域的 CAN 收发器、CAN SBC 等产品，最终形成“电源管理+信号链”双驱动产品体系，实现“手机+汽车”双平台战略布局落地。

传感器产品整体研发和导入进展顺利。在智能手机端，三合一窄缝传感器已经在大规模量产；OLED 屏下光传感器以及辅助影像增强的多光谱检测传感器正在研发中，预计下半年会进入客户送样阶段。在智能手表端，表冠旋钮检测芯片已在知名品牌客户的中高端手表开启国产替代和量产交付。在 TWS 耳机端，入耳检测传感器客户导入顺利，同时公司也在入耳检测传感的基础上迭代皮肤检测算法，推出皮肤检测接近传感器。在笔记本电脑和 LCD 大屏端，环境光检测传感器产品也已经推出。此外，公司还在拓展 dToF 和 iToF 等摄像头距离检测传感器以及 3D 人脸识别方面的传感器，希望对光传感相关的产品实现系列化，为

客户提供手机端和配件的一揽子解决方案。

SoC 方面，公司已经实现小功率到 100W 大功率的无线充电全系列产品覆盖，满足客户从手机到 PAD 到可穿戴设备端的整体应用方案需求。另外，为了协同无线充电，我们也加强了有线充电的技术储备，今年会推出为客户定制的电荷泵芯片和协议芯片方案。

模拟电源方面，公司更专注于拓展高附加值的细分领域，如车灯照明领域，如单路、三路以及 24 路的 LED 恒流驱动，应用在环绕灯、氛围灯中，相关产品正陆续导入业内知名车企供应链中。

2、公司如何看待目前无线充电生态的建立过程？

第一，无线充电技术在智能手机市场中已成为高端手机的基本配置，尤其在手机厂商和市场都主推的折叠屏手机、AI 手机以及旗舰手机中，无线充电渗透表现良好，且这一趋势将继续提升。

第二，随着无线充电生态的拓展和大众充电习惯的养成，无线充电技术正逐渐从高端手机下沉到低端市场，是必然的发展方向。目前，许多厂商都在尝试将无线充电技术应用到中低端手机上。随着人们越来越习惯使用无线充电，以及电动汽车的普及，越来越多的消费者在购买手机时会考虑到无线充电功能。

第三，手机厂商在考虑采用何种功率段的无线充电技术下沉时，需要权衡成本和市场需求。为满足不同客户面对无线充电下沉的需求，美芯晟也为这一趋势做好了准备，公司搭建了 30W-50W-80W 三个功率梯队的产品群，以供客户选择，更好应对下沉市场。

3、关注到公司发布的股票激励计划中其增长指引比较乐观，请问公司对未来产品结构的规划是如何的？

首先，传感器业务成功实现了从 0 到 1 的营收突破，未来其增速会非常快。这主要得益于产品的快速量产进程。目前，表冠旋钮检测芯片、TWS 入耳检测芯片以及窄缝三合一芯片等产品均已实现量产，并预计在今年年底前将上述产品的系列化芯片全

面推向市场。值得一提的是，公司在手机端规划的 OLED 屏下传感、全光谱检测传感、dToF 传感等产品，预计将在下半年开始进入客户送样测试阶段。另一方面，公司布局的传感器应用领域广泛，市场需求巨大。无论是在手机、手表、耳机等个人消费电子产品中，还是在个人笔记本电脑、智慧屏等高端设备中，一旦实现规模化销售，其潜在的市场规模将极为可观，有望为公司带来持续稳定的业绩增长。

其次，无线充电在 2024 年也会保持增长。得益于老客户终端需求数量的增加，以及最近新客户的拓展，尤其是海外客户，这些终端需求的增长将促进无线充电生态的进一步建立与业绩增长。另外，为了协同无线充电，我们也加强了有线充电的技术储备，这个市场也比较大，公司希望明年这些产品能够进入量产给公司带来增益。

再次，LED 业务已经相对成熟，为进一步拓宽业务领域，公司正积极开拓汽车电子照明市场，目前已有部分产品成功实现量产并在几家大型汽车制造商中使用。公司计划在明年完成所有照明驱动产品的研发，为后续增长奠定基础。

4、公司 CAN 系列产品的研发进度和规划如何？

在汽车电子领域，公司除了布局与现有消费类产品线高度协同的方向，如车载无线充电、汽车照明、雨量/雾气检测光传感等领域，更将专注于一些高集成度、国产替代亟需启动的领域。公司研发的 CAN SBC 芯片作为汽车控制系统的关键部件，目前由海外厂商所垄断，它是汽车电子领域集成了 CAN 收发器、系统模式和失效安全功能控制、电源管理等多种功能的高集成单芯片，适用于车身域 ECU 场景。在新能源电动车中，对 CAN 总线和 CAN SBC 芯片等零部件需求量很大，公司非常重视这方面的产品研发，均进行了产品布局。公司 CAN SBC 芯片的整体研发测试进展顺利，即将进入车规认证和送样阶段。此外，CAN PHY 接口芯片的研发已经启动，整体进展符合预期。公司将在汽车电子领域进行持续的技术创新和研发投入，致力于将其打造为业绩增长的新引擎。

5、请介绍下应用在智能手机端的光传感产品？

智能手机所应用的光感产品呈现出多元化的特点。以窄缝三合一光传感为例，它主要被应用于 LCD 屏幕上。而适用于 OLED 屏下的光传感器则需要更精确地测量设备当前的环境亮度和色温，同时还要满足低功耗的设计要求，这无疑增加了设计难度和相应成本。此外，多光谱检测传感器在影像增强方面发挥着重要作用，为实现手机的专业级拍照效果，需要集成 Flicker 闪烁检测、RGB 红绿蓝检测，甚至覆盖到非可见光领域，如 UV 和近红外波段。这种高级别的功能需求，使得其设计难度和费用都相对较高。以手机为例，高端智能手机如果配备齐全 5 颗光感芯片，其单机价值量比较可观。

6、2024 年公司人员增长规划和研发费用预算的是什么样的？

目前集成电路国产化进程迅猛，是企业成长的重要机遇之一。公司坚持长远发展战略，走可持续发展路线，不会因为短期费用影响而改变长期投入计划。公司希望在多个领域如 LED、无线充电、传感器等实现可持续发展，并加大有线快充和汽车电子等方面的发展，以带动公司的长期发展。因此，在行业下行周期优秀人才释放的大环境下，公司将根据今年新产品布局进行较大力度的人员招聘。如果遇到优秀的团队，公司不排除通过招聘或并购的方式将其纳入。

7、目前国内布局光传感器的公司相对较少，光传感器设计的难点有哪些？

光学传感器市场，尤其是高附加值市场主要由意法半导体（ST）、奥地利微电子(AMS)等欧美巨头以及台系厂商占据主导地位，长期以来，我国光学传感器市场较依赖进口，国产化率较低。目前光学传感器国产化较慢的主要原因在于其复杂的系统结构和较高的技术门槛。

光学传感器是一个完整的光学和数据采集系统，集成了光学、工艺、模拟、数字系统和图像处理等多领域的技术。该系统

	<p>通过深度融合光路设计、封装设计、垂直腔面发射激光器（VCSEL）、光电探测器（PD）工艺、镀膜技术以及数模混合 SoC 芯片等跨学科要素，实现了高度集成和系统级的应用。其工作原理是：从敏感元件接收到模拟电信号，由模拟前端通过放大器放大，再由模拟数字转换器把模拟信号转化为数字信号，经过 MCU 处理。其中，模拟前端是信号链的组成部分，一个完整信号链产品除了信号感知和处理外，还包括由数字模拟转换器还原为模拟信号的过程。此外，其封装生产过程相对复杂，需要确保光学系统在封装过程中不受污染；测试验证方面也需要进行多重定制化的电学、光学测试，由此可见，其技术壁垒较高，国内品牌较为稀缺。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 5 月 6 日